

## Silspher P2系列

专利号: ZL 201510781190.X


名称: 球形多孔二氧化硅

Silspher 球形多孔二氧化硅, 特点: 粒径大小均一型。采用优质硅源, 经过沉淀法工艺生产而来, 作为功能性粉体填充剂和添加剂, 可满足许多苛刻的应用。高硬度耐刮擦、化学性能稳定、耐冲击耐水煮、高耐候、折光率接近树脂做高透明度材料、高球化率、提升在零件上的填充率, 低密度颗粒减少零件重量, 降低成本并增强产品性能。在覆铜板、电子封装、LED、油墨、胶粘剂、油漆涂料、吸附缓释体、催化剂载体、色谱柱填充等方面有广泛的应用。

### 产品参数:

外观: (目测)	白色粉末
颗粒粒径, D50: $\mu\text{m}$ (激光粒度分布仪)	3、5、8、12
pH值: (2%水分散液, 直测)	5.0-9.0
干燥失重: (%, 105°C, 3小时)	$\leq 2$

### 产品规格:

产品名称	D 50 平均粒径 $\mu\text{m}$	吸油量 ml/100g	分散性质
Silspher P23	3		通用型
Silspher P25	5		通用型
Silspher P28	8		通用型
Silspher P212	12		通用型

### 产品特征及主要应用:

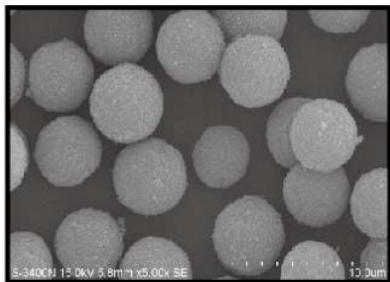
#### 产品特征:

- 球形白色粉体, 球化率高, 无气味
- 流动性强、滑爽性优, 应力低
- 99.9%含量高纯度二氧化硅, 金属杂质, 磁性离子含量少 100ppm
- 多孔结构、高孔隙率高孔容积、比表面积小、吸附性能优异, 缓释效果明显
- 化学性能稳定、无定型结构、非晶态无放射性元素、无毒无味, 耐高温、耐化学腐蚀、耐酸碱耐候性能稳定
- 0.5-20 $\mu\text{m}$  多种粒径规格, 粒径大小均一, 粒径分布窄
- 低介电常数 3.88/k、低损耗 0.0002 (1MHZ), 低膨胀  $0.5 \times 10^{-6}$
- 折光率 1.5 左右, 与大多树脂折光率 1.4-1.5 接近, 在橡塑、涂料、胶粘剂、LED 灯罩等产品中使用, 透光率高
- 莫氏硬度 6, 耐冲击耐刮耐磨
- 球形结构, 球面多孔、易散射, 吸收光线, 消光效果明显

**主要应用:**

- 1、电子行业：覆铜板、电子封装、LED
- 2、色谱柱填料
- 3、涂料、油墨、胶黏剂

**扫描电镜图:**



二氧化硅扫描电镜图  
SEM image of Silica

**仓储信息:**

产地:	中国
包装规格:	25 kg/桶
存储方法:	密封，阴凉干燥处避光保存
保质期:	36 个月

**编制日期: 2019/08/23**